

4-2-3-4 下地銅欠陥金めっきピット／基底銅層有缺陷引起鍍金層的凹坑／ Pit on gold deposit caused by base copper defect

【特徴】銅めっき欠陥そのままの形状をした金めっきピット

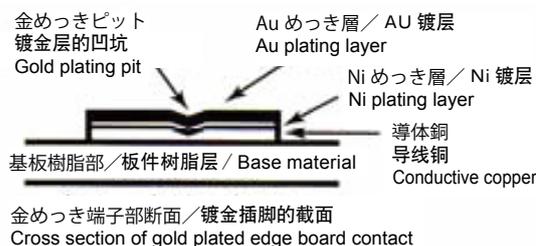
【特徴】鍍銅層の缺陷使得鍍金層出現凹坑。

【Characteristics】A pit on gold deposit is present exactly reflecting the shape of a defect of base copper.

【原因・判断ポイント・発生工程】銅めっき欠陥の上に金めっきされて出来たもの（銅めっき前～金めっき工程）

【原因、判断要点、发生工序】在鍍銅層の缺陷上鍍金所引起的（鍍銅前～鍍金工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Gold is plated on a defect of basis copper deposit. (Before copper plating - gold plating process)



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×

4-2-3-5 下地Ni欠陥金めっきピット／基底镍層有缺陷引起鍍金層的凹坑／ Pit on gold deposit caused by base nickel defect

【特徴】Niめっき欠陥そのままの形状をした金めっきピット

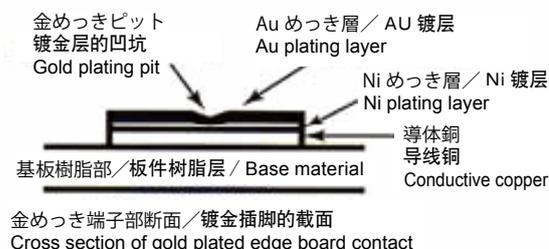
【特徴】镍層缺陷的形状在鍍金層表现出来。

【Characteristics】A pit on gold deposit is present exactly reflecting the shape of a defect of base nickel.

【原因・判断ポイント・発生工程】Niめっき欠陥の上に金めっきされて出来たもの（Niめっき～金めっき工程）

【原因、判断要点、发生工序】在鍍镍層の缺陷上鍍金所引起的（鍍镍～鍍金工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Gold is plated on a defect of basis nickel deposit. (Ni plating - gold plating process)



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×